

附表：系爭專利請求項 1 與證據 1、2 之技術比對表

項目	系爭專利請求項 1	證據 1	證據 2
1A	一種堆疊式封裝電子元件之壓測機構，包含：	第 6~7 頁及圖 1、2 揭示一種測試半導體封裝堆疊晶片之測試系統	說明書第[0019]段揭示「本發明為一種加工裝置轉接器，其會在熱測試期間同步接觸一頂端 IC(通常為一記憶體)以及一底部 IC(通常為邏輯裝置)」
1B	承載器：係設有至少一承載件；	說明書第 6~7 頁及圖 1、2 揭示測試機構 43 包括有一組框架 431、彈性構件 432 及探針測試裝置 433，探針測試裝置 433 之內部係具有一承載面 4331 及一探針介面板 4332，該承載面 4331 係用以容置該檢測晶片 5	
1C	測試單元：係裝配於該承載器之該承載件，並設有具至少一第一傳輸件之第一測試器，該第一測試器係承置至少一第一電子元件，並以該第一傳輸件之一端電性連接該第一電子元件，另一端則電性連接一第二電子元件；	說明書第 6~7 頁及圖 1、2 揭示探針測試裝置 433 之內部係具有一承載面 4331 及一探針介面板 4332，該承載面 4331 係用以容置該檢測晶片 5，而該承載面 4331 所容置之檢測晶片 5 能夠電性導接並向該測試座 411 方向延伸出複數個測試探針 4333，因此該測試探針 4333 一端則是與檢測晶片 5 電性導接，而測試探針 4333 另一端則能夠用於抵觸該測試座 411 上的待測晶片 61 上的微小電極接點	說明書第[0019]段揭示「本發明為一種加工裝置轉接器，其會在熱測試期間同步接觸一頂端 IC(通常為一記憶體)以及一底部 IC(通常為邏輯裝置)，並且在寬廣的溫度範圍中(舉例來說，-55℃至+150℃)維持兩個 IC 的溫度。」

項目	系爭專利請求項 1	證據 1	證據 2
1D	溫控單元：係裝配於該承載器之該承載件，並於該承載件裝配至少一第一溫控器，以使該第一電子元件保持預設測試溫度，該溫控單元另包括位於該第一溫控器之下方設置之至少一第二溫控器，以使該第二電子元件保持預設測試溫度。		第[0019]、[0028]、[0031]段揭示 PoP IC 裝置 130 的頂端 130 由熱裝置柱塞 105 來進行熱控制。更明確地說，該柱塞 105 會一起控制該頂端 IC 130 與該熱中介片 115，該熱中介片 115 會經由接觸來控制邏輯裝置 135。